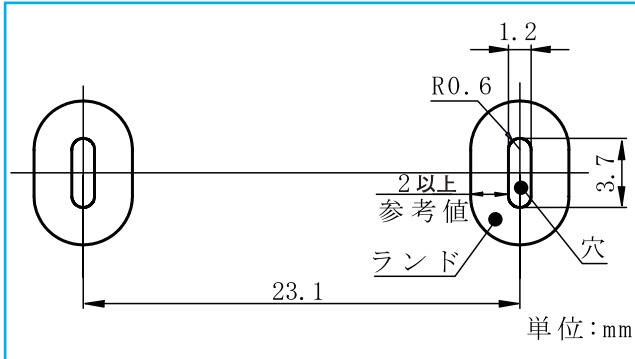


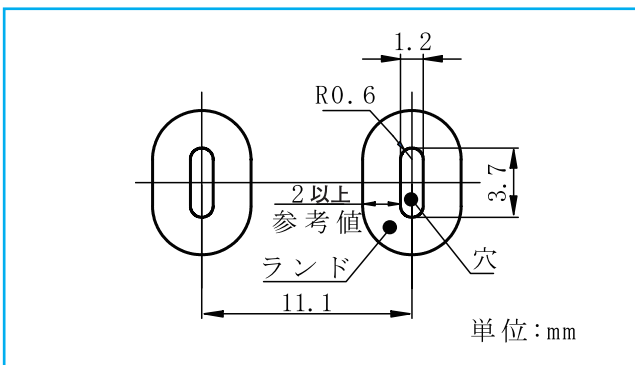
KHKシリーズヒューズ基板取付設計資料

1. 推奨取付穴ピッチ

●660KHKシリーズ



●400KHKシリーズ



2. 沿面距離、空間距離

ヒューズ遮断時においては両端子間に大きな電圧が加わります。パターン距離、他の部品との距離の推奨値を下表に示します。

シリーズ	対極となるパターン・距離		対極となるヒューズと部品の距離
	コーティングされた基板	コーティングなしの基板	
400KHK	3mm以上	5mm以上	4mm以上
660KHK	5mm以上	8mm以上	6mm以上

400KHKにおいて、基板上の汚染による絶縁低下の可能性があり、ヒューズ端子間の距離を大きく取る必要がある場合や、御社規定により端子間の距離が足りない場合には恐れ入りますが660KHKをご使用ください。

3. ヒューズ温度上昇

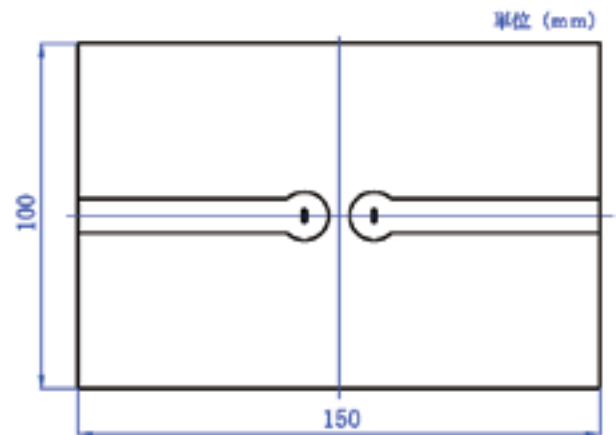
ヒューズの温度はパターンの幅、通電電流等により大きく変わります。下記に定格電流の50%の電流通電時に1A/mm(35μm 銅箔厚)となるパターンによる温度上昇特性を提示いたしますのでパターン設計の参考として下さい。

●条件

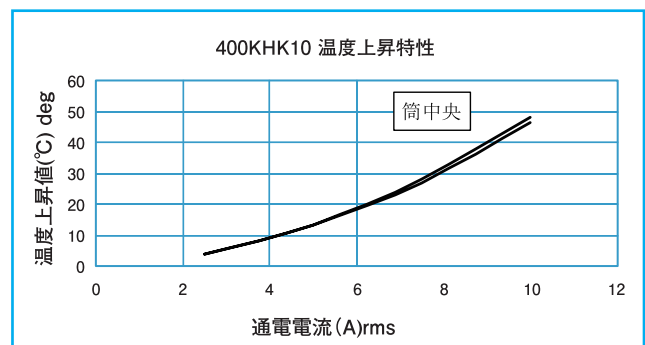
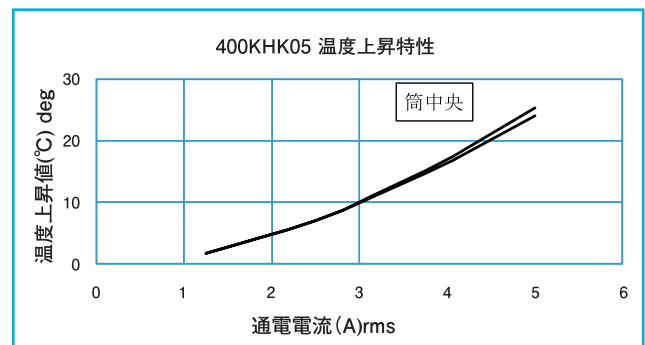
基板サイズ：150mm×100mm

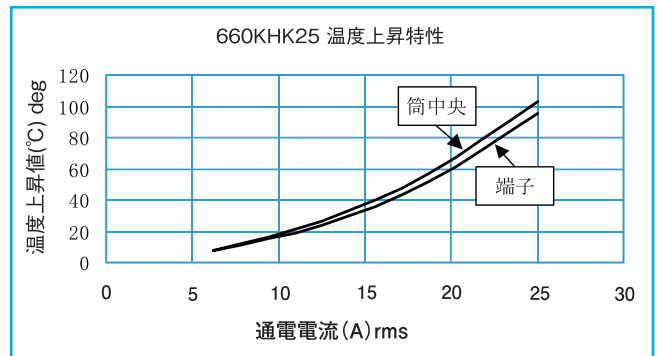
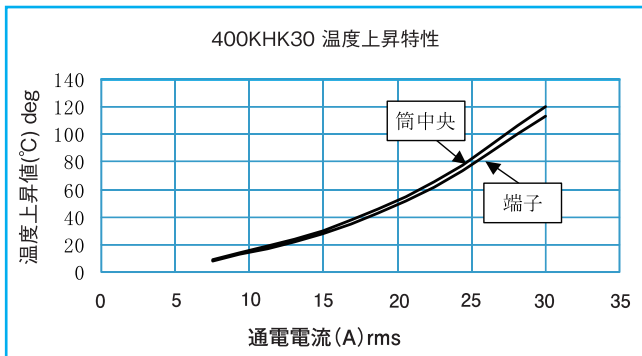
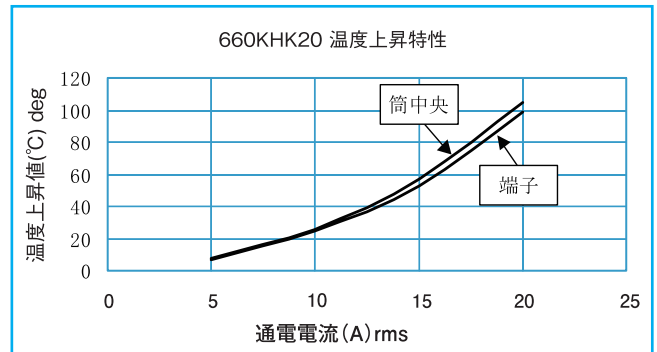
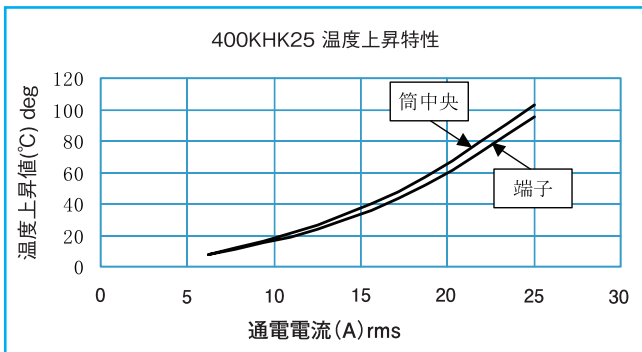
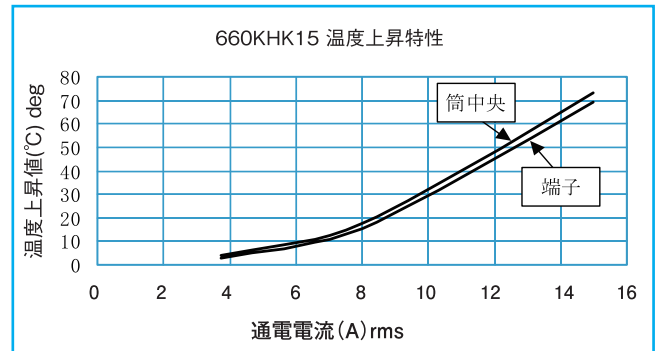
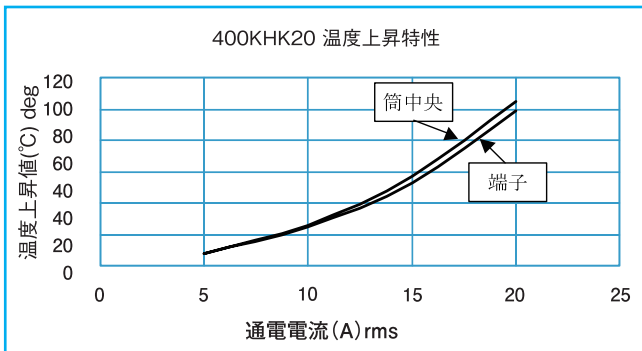
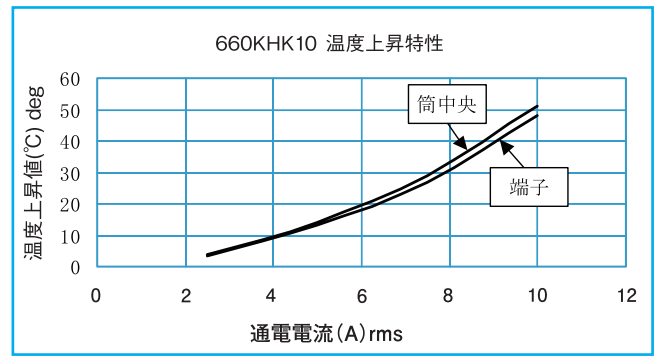
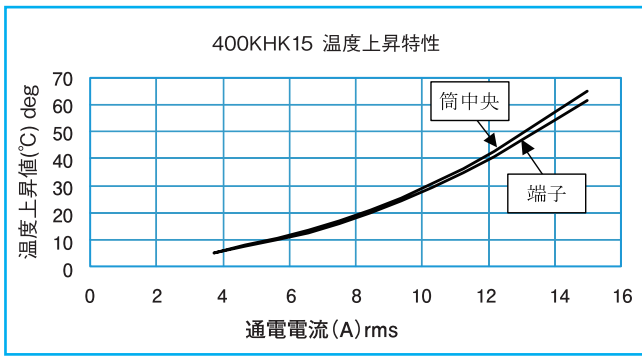
基板材質：FR-4

銅箔厚：35μm



●400KHK 温度上昇特性





●660KHK 温度上昇特性

